

立体配線の技術動向

IoT関連デバイス(スマートウォッチ等)、車載部品、ロボット、ドローン、ヘルスケア機器などの分野では更なる軽量化、高密度化、小型化に向け3次元(3D)の立体配線、部品実装が望まれています。既にスマホでは無線用配線が樹脂上に立体配線されており、新たな分野への展開が予想されています。

京都実装技術研究会では、本年度第2回例会として「立体配線の技術動向」をテーマに、需要拡大が期待される3次元立体配線と部品実装の最新動向を、材料・装置・工法の各分野から専門の講師をお招きしご講演いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和3年3月16日(火) 13:30 ~ 17:00

◇ 開催方式 Web方式 及び 会合方式 併用 (講師はWebでのご講演です)

◇ 会合会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

◇ 定員 Web: 応募状況により調整 会場: 若干名

◇ 内容

①【次世代3次元立体配線部品の開発】

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

機能材料技術部 高分子材料班 主査専門研究員 目黒 和幸 氏

立体的な形状へ電子部品を実装できる3次元成型回路(MID: Molded Interconnect Device)の高周波用途展開に向けて開発を進めている分子接合技術による平滑界面MID形成の取り組みについて紹介します。

②【立体回路基板用Cuペーストの開発】

昭和電工マテリアルズ株式会社

イノベーション推進本部 先端技術研究開発センタ 江尻 芳則 氏

近年、部材の軽量化や使用原材料の低減を目的に、3次元構造の成形樹脂に配線を形成して部品を実装した、MIDと呼ばれる立体回路基板が注目されています。当社では、環境負荷の低減やプロセスコスト低減のため、導電性ペーストによる銅配線形成を検討しています。本講演では、低温焼成可能な銅ペーストを用い、MIDへの適用可能性について報告します。

③【3Dプリンター技術を応用した3D電子デバイスの製造について】

株式会社FUJI

開発センター 技術部 課長 富永 亮二郎 氏

当社が開発している電子デバイス3Dプリンター“FPM-Trinity”は、基材造形、回路形成、部品実装の機能を複合した革新的な装置です。本講演では、この装置が実現する製造物や応用用途について事例を交えて紹介します。

④【IHリフロー技術の3DMIDにおける実装への応用】

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション

代表取締役社長 福田 光樹 氏

今回のテーマは3D-MID上でのはんだ付けをIHリフロー技術で行う提案です。同技術はコイルに交流電流を流し発生する磁束線を金属端子に当て瞬時に加熱、紙や布、PET、3D-MID等の低耐熱基板上でも熱影響を最小限にはんだ付けを実現できます。

- ◇ 参加費 無料
- ◇ 申込締切日 令和3年3月12日（金）まで
- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
 （京都実装技術研究会事務局）
 TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
 E-mail jisso@kptc.jp

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係 宛
 （ jisso@kptc.jp 又は FAX 075-315-9497）

令和2年度 京都実装技術研究会 第2回例会申込書

会社名			
所在地			
参加者	所属・役職		
	氏名		
	E-mail		
	電話番号		
2名以上 お申込み の場合	所属・役職	氏名	
参加方法	<input type="checkbox"/> Web参加 <input type="checkbox"/> 会場参加		

*申込書にご記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として利用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。